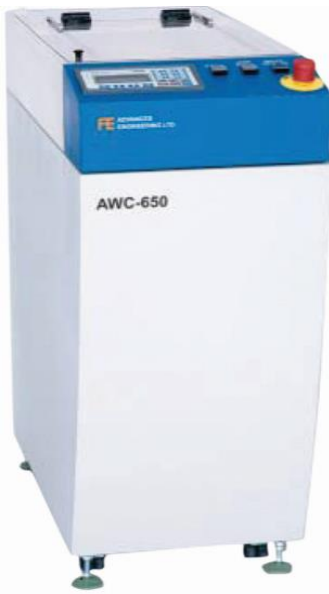




AWC-650

AWC-650 全自动晶片清洗装置是晶片切割后处理产品中的佼佼者，以其出众的高效性和灵活性，清除所有被切割和划割后的晶片和基体所产生的次微粒，**AWC-650**是一台牢固且灵活的机械装置，占地面积小，适用于任何切割环境。

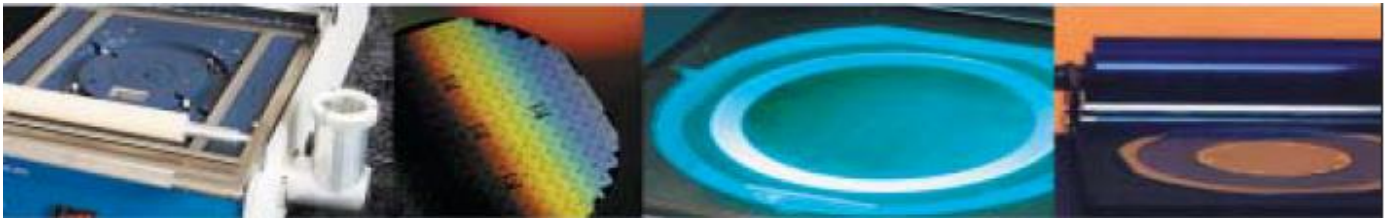


AWC-650优点

- 拥有 方便的字母式程序逻辑控制的液晶显示器
- 基体尺寸：适用于最大达8英寸的贴膜后的晶片
- 二流体喷雾水泵
- 简洁小巧的体积
- 最后的烘干处理使用了被净化过的氮气
- 内置式的真空发生器，配有具有自动排水功能的脱水器
- 内置式的排气吹风机
- 晶片释放功能采用了氮气
- 切割框架被安全的锁在底盘上
- 二氧化碳二度电离的功能选择
- 兆音波喷气口的功能选择

技术规格

二流体水压 (最小输入)	0.3Mpa (3公斤/平方厘米)
二流体水容量: (最高用量)	最高1.8公升/分钟
排水量 (最低)	> 1.8公升/分钟
氮气 (最高耗量)	70NL/分钟
空气 (CDA) (最高压力)	0.5-0.7Mpa (5-7公斤/平方厘米)
空气 (CDA) (最高耗量)	250NL/分钟
电压	110/220 Vac,50/60 Hz
功率 (最高限额)	1.8kVA
尺寸 (高*宽*长)	39*16*35英寸
	1000*400*870mm
重量	100公斤



AWC650-技术特点

采用最先进的清洗方法

具备最先进的二流体喷雾水泵和其他独具创意的清洗方式，AWC-650除了提供有效和具重复性的清洗程序，能让人无任何烦恼的处理个别的基体外，也能根据不同的应用情况提供最优的清洗效果。

简易的程序设置

使用AWC-650时，根据所需要的应用来设定一个最适合的清洗和烘干程序，是简单和有说明指引的程序。AWC-650的底盘旋转速度和二流体喷雾水的压力参数都可以按客户的特殊要求进行专门的设定，以符合个别的应用需求。处理参数可以轻易的更改和储存，以成立一个处理菜单的程序库。

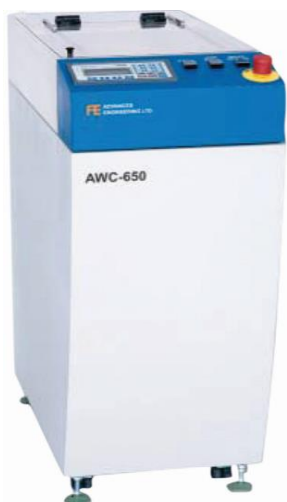
由微处理器进行控制的操作

AWC-650自动晶片清洗装置是由装置内的程序逻辑控制器进行数字控制的。底盘的转动速度、二流体喷雾的水管活动样式和速度、清洗和烘干周期阶段的时间和重复次数和其他的处理操作程序都可以精准的受控制和具有高度的重复操作性。清洗程序的处理菜单可轻易的在程序逻辑控制器的记忆装置里储存和随时准备被召回

系统的多功能性

AWC-650可为任何的应用需求进行设定和配置，以得到最优的清洗效果。系统选择包括：

- 兆音波的清洁喷水口使用一股兆音波强化的二流体喷雾来抨击掉基体表面上的微粒。
- 二氧化碳泡沫有效地防止静电在基体上的产生。
- 可为客户的任何应用要求定制底盘



地址：浦东新区东方路1361号

电话：021-58397708/7706

林向华 13816003459

网址：www.quest-tech.com.cn

邮箱：dannylim@quest-technology.com